

DIRECTRICES DE PROTECCIÓN DE TOPOGRAFÍAS DE SEMICONDUCTORES (LEY 11/1988)

**DEPARTAMENTO DE PATENTES E
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA**

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

Enero 2019

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN	1
SECCIÓN 1: LEGISLACIÓN INTERNACIONAL APLICABLE	2
1.1 LA PROTECCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA	2
1.2 ADPIC	2
1.3 ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS (SECCIÓN 6 DEL ANEXO 1C).....	3
1.4 EL OBJETO DE PROTECCIÓN EN LOS ADPIC.....	4
1.5 REQUISITOS DE PROTECCIÓN EN ADPIC	5
CAPÍTULO 2: EL MODO DE PROTECCIÓN	6
SECCIÓN 1: ALCANCE DE LA PROTECCIÓN Y CONCEPTOS	7
1.1 ALCANCE DE LA PROTECCIÓN	8
1.2 CONCEPTOS PROTEGIBLES.....	9
Ejemplo 1: Componente electrónico	10
Ejemplo 2: Circuito integrado o chip	11
Ejemplo 3: Circuito electrónico sobre placa base	11
SECCIÓN 2: PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN I: PRESENTACIÓN Y REQUISITOS	12
2.1 LUGAR DE PRESENTACIÓN	12
2.2 SOLICITUD	13
2.3 LA INSTANCIA.....	14
2.4 DESCRIPCIÓN	16
2.5 IDENTIFICACIÓN O REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TOPOGRAFÍA	16
2.6 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.....	17
SECCIÓN 3: PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN II: ASIGNACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN Y EXAMEN	19
3.1 FECHA DE PRESENTACIÓN	19
3.2 EXAMEN DE SOLICITUD.....	19
3.3 RESOLUCIÓN	20
CAPÍTULO 3: DISPOSICIONES ADICIONALES	21
SECCIÓN 1: REGISTRO DE TOPOGRAFÍAS	21
SECCIÓN 2: CONSULTA PÚBLICA.....	21
SECCIÓN 3: DISPOSICIÓN SOBRE APLICACIÓN SUPLETORIA	21
SECCIÓN 4: DURACIÓN Y MANTENIMIENTO	22
BIBLIOGRAFÍA	24

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene las principales directrices de procedimiento de concesión de una solicitud de protección de una topografía de semiconductor.

La normativa en la que se fundamentan las presentes directrices es la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de Topografías de los Productos Semiconductores; el Real Decreto 1465/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores y el Real Decreto 149/1996, de 2 de febrero, por el que se amplía la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores a los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio.

Estas directrices no tienen el carácter vinculante de un texto jurídico y se han elaborado con el objeto de proporcionar orientaciones prácticas en la aplicación de los diferentes textos legales en vigor. Aunque están dirigidas a los examinadores, permiten a los solicitantes y a sus agentes o representantes interpretar, comprender y anticipar las razones adoptadas en los informes y resoluciones.

La primera ventaja de los circuitos integrados es, sin duda alguna, la reducción de tamaño de los equipos electrónicos. De hecho, los primeros tipos se desarrollaron bajo el impulso de los programas espaciales, donde el peso y el tamaño son críticos.

En la actualidad, es posible reunir en una superficie de un centímetro cuadrado y con un grosor de pocas décimas de milímetro millones de transistores funcionando coordinadamente.

Las funciones de los semiconductores dependen en gran medida de sus topografías: las estructuras y disposición de los elementos, así como de las distintas capas que componen el circuito integrado (lo que en definitiva constituye su topografía), son resultado directo del diseño y representan una parte importante del esfuerzo creativo, exigiendo su concepción recursos humanos, técnicos y financieros.

Como consecuencia de ello, el coste del diseño resulta ser elevado al requerir:

- el diseño del circuito funcional
- el de cada elemento individual del circuito

- el de la disposición geométrica y
- el de las interconexiones.

Es, en cambio, relativamente fácil copiar este diseño, y este coste de copia muy inferior al necesario para su desarrollo, lo que lleva directamente a la piratería.

SECCIÓN 1: LEGISLACIÓN INTERNACIONAL APLICABLE

1.1 LA PROTECCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

La Directiva para la protección legal de productos semiconductores fue adoptada por el Consejo de la UE el 16 de diciembre de 1986 (<http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1410>) con el fin de armonizar la protección de la tecnología de los semiconductores. La Directiva establece algunas pautas a seguir por los Estados miembros:

1. No debe ser protegido el microchip en sí mismo, sino su topografía, esto es, "el patrón tridimensional de las capas de las que un semiconductor está compuesto". Una topografía puede protegerse si es el "resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no es común en la industria de los semiconductores".
2. El titular del derecho debe ser nacional de un estado miembro de la UE o tiene que comenzar la explotación comercial en la UE. De otra manera, la protección depende de las declaraciones especiales de los estados miembros de acuerdo con la Comisión.
3. El titular del derecho tiene el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción o explotación comercial.

1.2 ADPIC

Tras el fracaso en sacar adelante un Tratado para la protección de los circuitos integrados, la protección de la tecnología de los semiconductores fue regulada en la Sección 6 del Anexo 1C (artículos 35 a 38) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf. Estos artículos se reproducen a continuación.

1.3 ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS (SECCIÓN 6 DEL ANEXO 1C)

- Artículo 35: Relación con el Tratado IPIC

Los Miembros convienen en otorgar protección a los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados (denominados en el presente Acuerdo "esquemas de trazado") de conformidad con los artículos 2 a 7 (salvo el párrafo 3 del artículo 6), el artículo 12 y el párrafo 3 del artículo 16 del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados y en atenerse además a las disposiciones siguientes

- Artículo 36: Alcance de la protección

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 37, los Miembros considerarán ilícitos los siguientes actos si se realizan sin la autorización del titular del derecho: la importación, venta o distribución de otro modo con fines comerciales de un esquema de trazado protegido, un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido o un artículo que incorpore un circuito integrado de esa índole sólo en la medida en que éste siga conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido.

- Artículo 37: Actos que no requieren la autorización del titular del derecho

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36, ningún Miembro estará obligado a considerar ilícita la realización de ninguno de los actos a que se refiere dicho artículo, en relación con un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando la persona que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que

incorporaba un esquema de trazado reproducido ilícitamente. Los Miembros establecerán que, después del momento en que esa persona reciba aviso suficiente de que el esquema de trazado estaba reproducido ilícitamente, dicha persona podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento, pero podrá exigírsele que pague al titular del derecho una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería pagar por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado.

2. Las condiciones establecidas en los apartados a) a k) del artículo 31 se aplicarán mutatis mutandis en caso de concesión de cualquier licencia no voluntaria de esquemas de trazado o en caso de uso de los mismos por o para los gobiernos sin autorización del titular del derecho.
- Artículo 38: Duración de la protección
 1. En los Miembros en que se exija el registro como condición para la protección, la protección de los esquemas de trazado no finalizará antes de la expiración de un período de 10 años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.
 2. En los Miembros en que no se exija el registro como condición para la protección, los esquemas de trazado quedarán protegidos durante un período no inferior a 10 años contados desde la fecha de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.
 3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo Miembro podrá establecer que la protección caducará a los 15 años de la creación del esquema de trazado.

1.4 EL OBJETO DE PROTECCIÓN EN LOS ADPIC

El objeto de protección viene definido en el Art. 35 que se refiere a su vez al malogrado Tratado sobre la Protección de la Propiedad Intelectual en relación con los circuitos Integrados http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=295138, adoptado en la conferencia diplomática de la OMPI en Washington el 26 de mayo de 1989. Los ADPIC

adoptaron las definiciones del Tratado, que en su artículo 2, apartados (i) y (ii), define la topografía (es decir, el diseño del layout) como:

“(i) se entenderá por «circuito integrado» un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo y/o de la superficie de una pieza de material y que esté destinado a realizar una función electrónica.

(ii) se entenderá por «esquema de trazado (topografía)» la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

En definitiva, se protege la estructura tridimensional de los elementos de un circuito sobre un sustrato de semiconductor, que tiene una topografía específica. Cada circuito integrado funciona de acuerdo con un diagrama distinto.

La definición es, como se ve, prácticamente la de la directiva de la UE.

1.5 REQUISITOS DE PROTECCIÓN EN ADPIC

En ADPIC hay básicamente dos requisitos de protección: en primer lugar, deben ser originales en el sentido de que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y, en segundo lugar, no deben ser corrientes entre los creadores de esquemas de trazado (topografías) y los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creación.

Estos requisitos combinan elementos de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual. No existen hasta la fecha referencias en la jurisprudencia aplicada que puedan dar elementos de juicio para determinar su alcance.

CAPÍTULO 2: EL MODO DE PROTECCIÓN

Debido a la facilidad de su copia, se consideró necesario proteger de alguna manera efectiva a los creadores de este tipo de diseños que son las topografías. Analizando distintas opciones, puede estudiarse su protección:

- Como Patente de invención.

Para poder optar a la concesión de una patente, una invención debe cumplir con los requisitos de novedad y actividad inventiva. Es esta condición de actividad inventiva la que crea problemas en el caso de la mayoría de los esquemas de trazado de circuitos integrados semiconductores.

Un esquema de trazado no es el resultado sorprendente de una actividad inventiva, sino de un ingente trabajo realizado entre equipos de expertos muy especializados y con la ayuda de equipo sofisticado. Tal trabajo intensivo no puede considerarse como actividad inventiva y por tanto, no podría concederse como una patente de invención.

- Como Modelo de Utilidad.

Es el mismo caso anterior, aunque en algunas legislaciones como la española, la actividad inventiva requerida para los modelos de utilidad sea de un nivel inferior al que se requiere para las patentes de invención.

- Como Diseño Industrial.

Presenta dificultades de aplicación al tratarse con esta modalidad de la protección de creaciones estéticas.

- Como Propiedad intelectual.

Para que fuese protegido como derecho de autor, habría que plantearse la cuestión de si tal esquema podría considerarse como una producción en el campo literario, científico o artístico. Porque, en realidad, aunque constituya una creación intelectual, el esquema de trazado viene determinado por consideraciones técnicas y tiene un carácter puramente

utilitario. Es, por tanto, dudoso que el esquema pueda considerarse una obra a la que pueda aplicarse el derecho de autor.

- Frente a la Competencia desleal.

En este capítulo, se exige la existencia de un acto de competencia. Es el caso de una empresa comercial que vende artículos que contienen circuitos integrados (CIs) con un esquema de trazado copiado. Por ejemplo, equipos de televisión con CIs falsificados.

Esta empresa, normalmente, sólo podrá ser demandada por otra empresa competidora, es decir, que venda también equipos de televisión, pero no necesariamente será demandada por el creador del esquema de trazado.

Además, un acto de competencia desleal puede variar según el juez que decida la cuestión. Por lo tanto, es difícil saber qué es un acto de competencia desleal y qué no lo es.

- Mediante Leyes específicas.

Las primeras leyes en torno a las topografías de los productos semiconductores son las de EEUU en 1984, Japón en 1985 y la Directiva Europea de 1986, relativa a la armonización de las leyes en este sentido, con incidencia directa en el funcionamiento del mercado comunitario.

Consecuencia de esta Directiva es la Ley 11/1988 de 3 de mayo de Protección Jurídica de las Topografías de los Productos Semiconductores.

Esta ley va dirigida a proteger los esquemas de trazado, la configuración o disposición tridimensional de los elementos de un circuito, en el que los elementos activos, las interconexiones y los elementos pasivos forman parte del cuerpo de:

- un sustrato semiconductor,
- una microplaqueta semiconductor,
- un chip o circuito integrado.

SECCIÓN 1: ALCANCE DE LA PROTECCIÓN Y CONCEPTOS

1.1 ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

A los efectos de la Ley 11/1988 y según su Artículo 1:

1. **Un producto semiconductor** es la FORMA FINAL o INTERMEDIA de cualquier producto:
 - a. Constituido por un sustrato que incluya una capa de material semiconductor.
 - b. que tenga una o más capas suplementarias de materiales conductores, aislantes o semiconductores, dispuestas en función de una estructura predeterminada.
 - c. destinado a desempeñar, exclusivamente o junto con otras funciones, una función electrónica.
2. **Topografía de un producto semiconductor:** está constituido por una serie de imágenes interconectadas, sea cual fuere la manera en que estén fijadas o interconectadas:
 - a. Que representen la estructura tridimensional de las capas que componen el producto semiconductor.
 - b. en la cual cada imagen tenga la estructura o parte de la estructura de una de las superficies del producto semiconductor en cualquiera de sus fases de fabricación.
3. **Explotación comercial:** la venta, el alquiler, el arrendamiento financiero o cualquier otro método de distribución comercial o una oferta con dichos fines.

Por otra parte y en sucesivos artículos, la Ley 11/1988 también establece cuáles son:

- Los requisitos de protección (Artículo 2).
- Derecho a la protección (Artículo 3).
- Cómo debe efectuarse el registro de la topografía (Artículo 4).
- Cuál es el contenido de los derechos exclusivos (Artículo 5).
- Licencias obligatorias (Artículo 6).
- Duración de la protección (Artículo 7).
- Acciones por violación de derechos exclusivos (Artículo 8).
- Extensión de la protección (Artículo 9).
- Signos indicativos de la protección (Artículo 10).
- Mantenimiento de otras disposiciones legislativas (Artículo 11).

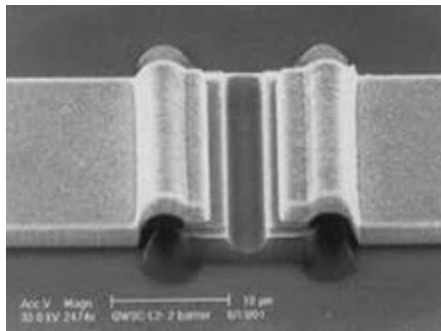
1.2 CONCEPTOS PROTEGIBLES

Desde el punto de vista de los productos y topografías de semiconductores, se pueden establecer tres conceptos protegibles de acuerdo al nivel del diseño que se pretende proteger mediante esta modalidad. Estos tres conceptos recogen los distintos niveles a los cuales se puede circunscribir el esfuerzo de diseño de un producto basado en semiconductores, esto es: a nivel del componente electrónico, a nivel del chip o circuito integrado y a nivel del circuito o placa base que incorpora a los anteriores. En todos los casos se trata de proporcionar la protección al diseño de uno o varios elementos que incorporan materiales semiconductores. Ello junto con otros materiales necesarios (metales, aislantes u otros) y de las interconexiones entre ellos, para el desarrollo de una función eléctrica o electrónica de manera que el conjunto se dispone sobre uno o varios sustratos, en capas, con una configuración específica.

Debido a los enormes avances en la miniaturización de los componentes y en las técnicas de integración, las escalas de tamaño empleadas han ido reduciéndose en la misma medida en el transcurso de las últimas décadas. Desde el nivel más básico y reducido en tamaño al nivel más complejo y de tamaño más importante, se proporcionan a continuación unos ejemplos meramente ilustrativos de cada uno de los tres conceptos susceptibles de encaje dentro de esta modalidad de protección.

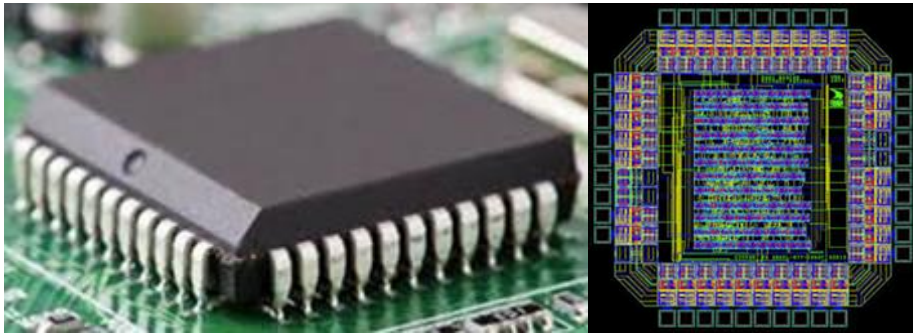
Ejemplo 1: Componente electrónico

Al nivel de componente electrónico, se puede citar por ejemplo el diseño o configuración específica de un transistor, diodo u otro componente electrónico cuya configuración incluya el empleo de materiales semiconductores y técnicas de litografía. Ello incluye el propio componente en su composición por capas de material y los elementos pasivos que permiten su integración en el sustrato sobre el que se ha depositado, como en la siguiente Figura.



Ejemplo 2: Circuito integrado o chip

El segundo nivel de complejidad y que conceptualmente se basa en la integración de múltiples componentes electrónicos en un único circuito integrado o chip queda plasmado en las siguientes ilustraciones. Se puede ver un dispositivo de este tipo ensamblado, así como un diseño de su topografía. Esta topografía incluye componentes sobre un sustrato semiconductor, pistas metálicas para la interconexión de estos elementos, así como los conocidos como pines que permiten la conexión o integración del chip en un circuito más amplio. Entre este tipo de dispositivos se pueden citar por ejemplo memorias, procesadores o dispositivos de E/S.



Ejemplo 3: Circuito electrónico sobre placa base

A partir de los elementos anteriores se pueden diseñar circuitos electrónicos con funcionalidades más complejas en las que intervienen múltiples chips y componentes que quedan dispuestos en un determinado sustrato (en una o varias capas) y realizan conjuntamente una determinada función. El esfuerzo del diseño se centra en este caso en la configuración de los distintos elementos del circuito y su disposición sobre una placa mediante la cual quedan interconectados. Pueden verse, en las siguientes ilustraciones, dos ejemplos de circuitos electrónicos genéricos sobre una placa base.



SECCIÓN 2: PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN I: PRESENTACIÓN Y REQUISITOS

De acuerdo con el Real Decreto 1465/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, para la Protección Jurídica de las Topografías de los Productos semiconductores, se establecen las siguientes características para el procedimiento de tramitación. De entre ellas, el Lugar de Presentación queda recogido en la Ley 11/1988, mientras que el resto de elementos se detallan en el Reglamento de ejecución de la misma.

2.1 LUGAR DE PRESENTACIÓN

Originalmente y según la Ley 11/1988, de 3 de mayo, los lugares de presentación previstos eran:

- Artículo 4.1. Lugar de presentación.

1. La solicitud de registro podrá presentarse:

- a) Directamente en el Registro de la Propiedad Industrial.
- b) En las Direcciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía, salvo en el caso previsto en el apartado c) siguiente.
- c) En los Órganos competentes de las Comunidades Autónomas que tengan reconocida la competencia para la ejecución en materia de propiedad industrial.
- d) En las oficinas de Correos, de acuerdo con el artículo 66.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958.

2. En los casos contemplados en los apartados b) y c) la unidad administrativa que haya recibido la solicitud la remitirá al Registro de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y según su artículo 16.4, se podrá realizar la presentación de una solicitud:

“4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:

- a) *En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.*
- b) *En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.*
- c) *En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.*
- d) *En las oficinas de asistencia en materia de registros.*
- e) *En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.*

Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.”

2.2 SOLICITUD


- Artículo 2. Solicitud.
 1. La solicitud de registro de una topografía de un producto semiconductor sólo puede comprender y referirse a una topografía.
 2. La solicitud de registro deberá comprender:
 - a. Una instancia.
 - b. Una descripción.
 - c. Una identificación o representación gráfica.
 - d. Documentos complementarios, en su caso.
 3. Con la solicitud deberá acompañarse el justificante de pago de la tasa prevista en el apartado 4.1 de la disposición adicional primera de la Ley 11/1988.

2.3 LA INSTANCIA

- Artículo 3. Instancia.

La instancia por la que se solicita el registro deberá dirigirse al Director del Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y estar firmada por el solicitante o su representante. Esta instancia está disponible en el enlace: https://sede.oepm.gob.es/eSede/comun/Formularios_web/TP2.pdf En ella deberán figurar los siguientes datos:

- a) Que se solicita la protección jurídica de la topografía de un producto semiconductor (según el documento de solicitud modelo TP2).

 <p>MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO</p>	 <p>Oficina Española de Patentes y Marcas</p>	Nº SOLICITUD:
		FECHA Y HORA DE ENTRADA EN OEPM:
		FECHA Y HORA DE ENTRADA EN LUGAR DISTINTO A LA OEPM:

INSTANCIA DE SOLICITUD PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA TOPOGRAFÍA DE UN PRODUCTO SEMICONDUCTOR

- b) Nombre y apellidos o denominación social del solicitante, su nacionalidad y domicilio. Tratándose de personas jurídicas se identificarán por su razón social o de acuerdo con las disposiciones legales por las que se rijan. Las personas físicas deberán hacer constar el número de su documento nacional de identidad o, a falta del mismo, el de otro documento similar.

1. IDENTIFICACIÓN DEL/LOS SOLICITANTE/S

APELLIDOS Y NOMBRE/DENOMINACIÓN SOCIAL				NIF/PASAPORTE	
DATOS DEL PRIMER SOLICITANTE:					
DIRECCIÓN POSTAL		CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD	PROVINCIA	PAIS	CODIGO PAIS
DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO		Nº TELÉFONO	INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE		
			<input type="checkbox"/> CORREO POSTAL <input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO		
PORCENTAJE DE TITULARIDAD DEL SOLICITANTE DE LA TOPOGRAFÍA		NOTA: DE NO ESPECIFICARSE DICHO PORCENTAJE, LA OEPM PRESUMIRÁ IGUALES LAS CUOTAS DE LOS SOLICITANTES.			

- c) La designación del creador o creadores de la topografía del producto semiconductor; en el supuesto de que el solicitante no fuera el creador o el único creador, se mencionará cómo ha adquirido el derecho a la topografía, y la existencia de otros creadores en hoja complementaria.

EL SOLICITANTE TAMBIÉN ES CREADOR	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	MODO DE OBTENCIÓN DEL DERECHO
		<input type="checkbox"/> INVENCIÓN LABORAL <input type="checkbox"/> CONTRATO <input type="checkbox"/> SUCESIÓN <input type="checkbox"/> OTROS (Especificar):

2. IDENTIFICACIÓN DEL CREADOR (no rellenar si el/los solicitante/s coincide/n con el/los creador/es)

APELLIDOS	NOMBRE	NACIONALIDAD	CODIGO NAC.	NIF/PASAPORTE.

3. OTROS SOLICITANTES Y/O CREADORES

<input type="checkbox"/> LOS DEMÁS SOLICITANTES Y/O CREADORES SE INDICAN EN HOJA COMPLEMENTARIA

- d) La fecha de iniciación de la primera explotación comercial no secreta de la topografía del producto semiconductor, cuando dicha fecha sea anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro.

4. OTROS DATOS

TÍTULO DE LA TOPOGRAFÍA
FECHA DE INICIACIÓN DE LA PRIMERA EXPLOTACIÓN COMERCIAL NO SECRETA DE LA TOPOGRAFÍA
DECLARACIÓN
El solicitante o representante abajo firmante declara que la topografía del producto semiconductor objeto de esta solicitud es el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no es corriente en la industria de los semiconductores <input type="checkbox"/>

- e) Si el solicitante está representado por un Agente de la Propiedad Industrial, el nombre de éste, su domicilio profesional y su código de identificación.

5. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE

REPRESENTACIÓN		Nº PODER GENERAL	
<input type="checkbox"/> EL SOLICITANTE NO ESTÁ REPRESENTADO	<input type="checkbox"/> EL SOLICITANTE ESTÁ REPRESENTADO POR:	<input type="checkbox"/> AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/> OTRO REPRESENTANTE
ACTUACIÓN POR MEDIO DE AGENTE	NOMBRE:	CODIGO DE AGENTE:	
ACTUACIÓN POR MEDIO DE OTRO REPRESENTANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN POSTAL	
DIRECCION CORREO ELECTRONICO	Nº TELEFONO	INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE	
		<input type="checkbox"/> CORREO POSTAL <input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO	

- f) Un título sucinto y preciso de la topografía del producto semiconductor. El título podrá incluir los nombres de los productos que componen la topografía y el ámbito de aplicación de la misma (ver anteriormente Apartado 4 de la solicitud).
- g) Una declaración por la que se indique que la topografía del producto semiconductor es el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no es corriente en la industria de semiconductores.
- h) Relación de documentos que se acompañan a la solicitud.

5. ÍNDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN

<input type="checkbox"/> IDENTIFICACIÓN O REPRESENTACIÓN	<input type="checkbox"/> DESCRIPCIÓN	FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO PÚBLICO FECHA DE EXPLOTACIÓN	<input type="checkbox"/> GRÁFICO	
<input type="checkbox"/> DECLARACIÓN DE SECRETO COMERCIAL	<input type="checkbox"/> MUESTRAS	FIRMA DEL FUNCIONARIO
<input type="checkbox"/> JUSTIFICANTE DE PAGO DE TASA SOLICITUD	<input type="checkbox"/> DOCUMENTO DE REPRESENTACIÓN	
<input type="checkbox"/> JUSTIFICANTE DE PAGO DE TASA DEPÓSITO	<input type="checkbox"/> OTROS:	

2.4 DESCRIPCIÓN

- Artículo 4. Descripción.

La descripción de la topografía del producto semiconductor comprenderá un texto redactado de forma **clara y concisa, pudiendo contener referencias a la representación gráfica**. En la descripción podrá indicarse la utilización o utilizaciones a que está destinada la topografía.

2.5 IDENTIFICACIÓN O REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TOPOGRAFÍA

- Artículo 5. Identificación o representación gráfica de la topografía.

1. La identificación o representación gráfica estará constituida, en forma que revele la estructura tridimensional, por dibujos, fotografías o por ambos:
 - a. De los esquemas para la fabricación del producto semiconductor.
 - b. De las máscaras o parte de las máscaras para la fabricación del producto semiconductor, o
 - c. De las capas del producto semiconductor.
2. Además de la documentación mencionada que identifica o representa la topografía, podrán presentarse soportes de datos en los que las capas de la topografía estén registradas en forma codificada, listados de estos soportes de datos o muestras de la topografía del producto semiconductor.
3. En el supuesto de que se deposite el material consistente en las muestras de la topografía del producto semiconductor, se abonará la tasa prevista en el apartado 4.2 de la disposición adicional primera de la Ley 11/1988, de 3 de mayo.
4. En el caso de existir secretos comerciales, el solicitante deberá presentar, además del ejemplar original de la documentación y el material previsto en los apartados anteriores, un segundo ejemplar con las partes secretas desfiguradas. Únicamente quedará sometido a consulta pública el ejemplar desfigurado. Las partes secretas podrán marcarse con la letra «**S**».

2.6 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

- Artículo 6. Documentación complementaria.

En su caso, la solicitud deberá estar acompañada de los siguientes documentos complementarios:

- a) Autorización firmada por el solicitante a favor del Agente de la Propiedad Industrial que lo represente.
- b) Declaración en documento público referente a la fecha de iniciación de la primera explotación comercial no secreta de la topografía del producto semiconductor, cuando dicha fecha sea anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro.
- c) Declaración relativa a las partes de la documentación y del material que identifiquen o representen la topografía del producto semiconductor que

constituyen secreto comercial. En todo caso, deberá quedar asegurada la identificación de la topografía.

- Artículo 7. Normas generales relativas a la presentación de los documentos de la solicitud.

Todos los documentos de la solicitud de registro deberán presentarse en formato A-4 (29,7 por 21 centímetros). Si resulta imprescindible presentar documentación que exceda de dicho formato, se aportará plegada según formato A4.

- Artículo 8. Recepción de documentos.
 1. El funcionario de la unidad administrativa que reciba la documentación hará constar la fecha, la hora y el minuto de su recepción, comprobará si se acompañan a la instancia los documentos expresados en la misma y la remitirá, en su caso, al Registro de la Propiedad Industrial. Si se hubiese entregado en una oficina postal, se hará constar asimismo, el día, la hora y el minuto de su recepción.
 2. Se deberá facilitar al solicitante un justificante de la entrega de la documentación aportada.

SECCIÓN 3: PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN II: ASIGNACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN Y EXAMEN

3.1 FECHA DE PRESENTACIÓN

- Artículo 9. Fecha de presentación.
 1. A los efectos del artículo 7.1, apartado b) de la Ley, se considerará como fecha de presentación, aquella en que tenga lugar de acuerdo con el artículo 1.1 del presente Reglamento, comprendiendo la siguiente documentación:
 - a. La instancia de la solicitud de registro.
 - b. La descripción de la topografía.
 - c. La identificación o representación gráfica de la topografía.
 - d. El justificante del pago de la tasa por solicitud de registro.

Estos documentos constituyen los documentos mínimos para obtener una fecha de presentación.

2. Dentro de los diez días contados desde la recepción en sus oficinas, la OEPM rechazará de plano, haciendo la correspondiente notificación al interesado, las solicitudes que no contengan los documentos mencionados en el apartado anterior.

Atención: *Un solicitante puede perder la posibilidad de registrar una topografía que ha sido explotada comercialmente 2 años antes si ha dejado pasar ese plazo y no se le admite a trámite por la falta de alguno de estos documentos*

3.2 EXAMEN DE SOLICITUD

- Artículo 10. Examen de solicitud.
 1. Admitida a trámite la solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial examinará si la misma se ajusta a lo preceptuado en los artículos 2 al 7 del presente Reglamento.
 2. Asimismo, comprobará en su caso:
 - a. Si la tasa de depósito de material ha sido pagada.

- b. Si la fecha de presentación de la solicitud está comprendida dentro del plazo de los dos años anteriores, contados a partir de la fecha de iniciación de la primera explotación comercial.
3. Si como resultado del examen previsto en el apartado anterior, la solicitud de registro presentase algún defecto, el Registro de la Propiedad Industrial comunicará las objeciones para que el solicitante, en el plazo de dos meses, subsane los defectos o efectúe las alegaciones que estime oportunas en defensa de la solicitud de registro.

3.3 RESOLUCIÓN

- Artículo 11. Resolución.
 1. Si del examen realizado conforme a lo previsto en el artículo 10, no resultan defectos que impidan la concesión o cuando tales defectos hubieran sido debidamente subsanados, el Registro de la Propiedad Industrial concederá el registro.
 2. El Registro de la Propiedad Industrial denegará la solicitud de registro cuando subsistan defectos que no hubieran sido debidamente subsanados en el plazo otorgado al efecto.
 3. Se publicarán en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» las menciones relativas a la concesión o denegación con los datos necesarios para la identificación de la solicitud.

CAPÍTULO 3: DISPOSICIONES ADICIONALES

SECCIÓN 1: REGISTRO DE TOPOGRAFÍAS

- Artículo 12. Registro de topografías.
 1. En el Registro de la Propiedad Industrial se llevará un Registro de topografías de productos semiconductores donde se inscribirán los datos identificativos del expediente, así como las menciones relativas tanto a la tramitación de las solicitudes de protección como las que afecten posteriormente a su vida legal.
 2. Particularmente, se inscribirá en el citado Registro cuando así proceda, la fecha de iniciación de la primera explotación comercial no secreta de la topografía del producto semiconductor, cuando dicha fecha sea anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro.

SECCIÓN 2: CONSULTA PÚBLICA

- Artículo 13. Consulta pública.
 1. El Registro de topografías de productos semiconductores estará abierto a consulta pública.
 2. Asimismo, se pondrán a disposición del público, una vez publicada la mención de concesión, todos los documentos de la solicitud y, en su caso, la muestra de la topografía del producto semiconductor, siempre que no exista secreto comercial.
 3. Los documentos y muestras mencionados en el apartado 2 no podrán ser copiados ni entregados sin autorización del titular registral.

SECCIÓN 3: DISPOSICIÓN SOBRE APLICACIÓN SUPLETORIA

- DISPOSICION ADICIONAL

Aplicación supletoria de la legislación de patentes.

En defecto de norma expresamente aplicable, regirán para las topografías de los productos semiconductores las disposiciones del Reglamento de ejecución de la

Ley 11/1986, de 20 de marzo, siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquéllas. Entre otras, le serán aplicables las normas relativas a los procedimientos de concesión y transmisión de patentes.

Actualmente la Ley de Patentes 11/1986 ha sido derogada por la vigente Ley 24/2015, de 24 de Julio, de Patentes.

SECCIÓN 4: DURACIÓN Y MANTENIMIENTO

A partir de lo estipulado en la Ley 11/1988, se detallan las cuestiones de la duración de la protección y el mantenimiento de la misma.

- Artículo 7. Duración de la protección.
 1. Los derechos exclusivos contemplados en el artículo 2 nacerán en la primera en el tiempo, de las fechas siguientes:
 - a. En la que la topografía ha sido objeto de explotación comercial por primera vez en cualquier lugar del mundo.
 - b. En la que se haya presentado la solicitud de registro en debida forma.
 2. Los derechos exclusivos expirarán transcurridos diez años contados a partir de la primera en el tiempo de las siguientes fechas:
 - a. El fin del año en el que la topografía ha sido objeto de explotación comercial por primera vez en cualquier lugar del mundo.
 - b. El fin del año en el que se haya presentado la solicitud de registro en debida forma.

No obstante, quedará sin efecto todo registro relativo a una topografía que no haya sido objeto de explotación comercial en ningún lugar del mundo en el plazo de quince años, contados a partir de la fecha de su primera fijación o codificación.

Finalmente, la Disposición Adicional Primera de la Ley establece el pago de una tasa al Registro de la Propiedad Industrial que cubre la solicitud de registro, el depósito de

material y la inscripción de transferencias. En esta modalidad de protección no se pagan tasas de mantenimiento o anualidades como sí se hace en otras modalidades.

BIBLIOGRAFÍA

Oficina Alemana de Patentes y Marcas [en línea]

https://www.dpma.de/english/utility_models/topographies/index.html [Accedido:12/09/2018].

Hoeren, Thomas et al. *The protection of semiconductor chip products in TRIPS*. [en línea]

http://www.unimuenster.de/Jura.itm/hoeren/veroeffentlichungen/hoeren_veroeffentlichung_en/The%20protection_of_semiconductor_chip_products_in_TRIPS.pdf [Accedido: 12/09/2018].

Ríos Ruíz, Wilson Rafael et al. (2001) «Propiedad intelectual respecto de los circuitos integrados -chips-» en *Revista La propiedad inmaterial* (Español). ISSN: 1657-1959 [en línea] <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3985834> (pdf) [Accedido: 12-09-2018].